

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【公開番号】特開2004-31731(P2004-31731A)

【公開日】平成16年1月29日(2004.1.29)

【年通号数】公開・登録公報2004-004

【出願番号】特願2002-187256(P2002-187256)

【国際特許分類第7版】

H 0 5 K 3/46

【F I】

H 0 5 K 3/46 S

H 0 5 K 3/46 B

【手続補正書】

【提出日】平成16年8月17日(2004.8.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 7】

(2) また、本実施形態の製造方法では、積層された金属箔83, 84のエッティング(即ちサブトラクティブ法)により、配線層31, 32, 51, 52のパターン形成を行うようにしている。よって、アディティブ法によりパターン形成を行う場合に比べて、短時間かつ低コストで上記構成の積層樹脂配線基板11を製造することができる。